

# 中国LED封装产业发展现状及发展定位研究报告

## 报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《中国LED封装产业发展现状及发展定位研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/224804224804.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

### 第一章 LED封装相关概述

#### 1.1 LED封装简介

##### 1.1.1 LED封装的概念

##### 1.1.2 LED封装的形式

##### 1.1.3 LED封装的结构类型

##### 1.1.4 LED封装的工艺流程

#### 1.2 LED封装的常见要素

##### 1.2.1 LED引脚成形方法

##### 1.2.2 LED弯脚及切脚

##### 1.2.3 LED清洗

##### 1.2.4 LED过流保护

##### 1.2.5 LED焊接条件

### 第二章 2013-2015年LED封装产业总体发展分析

#### 2.1 2013-2015年世界LED封装业的发展

##### 2.1.1 总体特征

##### 2.1.2 区域分布

##### 2.1.3 企业格局

#### 2.2 2013-2015年中国LED封装业的发展

##### 2.2.1 发展现状

##### 2.2.2 产值增长情况

##### 2.2.3 产品结构分析

##### 2.2.4 产业链分析

##### 2.2.5 产能分析

##### 2.2.6 价格分析

#### 2.3 2013-2015年国内重要LED封装项目进展

##### 2.3.1 欧司朗在华首个LED封装项目投产

##### 2.3.2 福建安溪引进LED封装线项目

##### 2.3.3 瑞丰光电扩产SMD LED项目

##### 2.3.4 徐州博润LED芯片封装项目开建

##### 2.3.5 晶圆级芯片封装项目落户淮安

##### 2.3.6 厦门信达增资扩建LED封装项目

### 第三章 2013-2015年中国LED封装市场格局分析

#### 3.1 2013-2015年LED封装市场发展态势

### 3.1.1 LED封装市场运行特征

### 3.1.2 LED封装市场需求结构

### 3.1.3 LED封装企业规模扩大

### 3.1.4 LED封装市场发展变局

### 3.1.5 封装市场上下游战略合作

## 3.2 2013-2015年LED封装企业布局特征

### 3.2.1 区域分布格局

### 3.2.2 珠三角地区分布特点

### 3.2.3 长三角地区分布特点

### 3.2.4 其他地区分布特点

## 3.3 2013-2015年广东省LED封装业分析

### 3.3.1 产业规模

### 3.3.2 主要特点

### 3.3.3 重点市场

### 3.3.4 发展趋势

## 第四章 2013-2015年LED封装行业技术研发进展

### 4.1 中外LED封装技术的差异

#### 4.1.1 封装生产及测试设备差异

#### 4.1.2 LED芯片差异

#### 4.1.3 封装辅助材料差异

#### 4.1.4 封装设计差异

#### 4.1.5 封装工艺差异

#### 4.1.6 LED器件性能差异

### 4.2 2013-2015年中国LED封装技术研发分析

#### 4.2.1 封装技术影响LED光源发光效率

#### 4.2.2 LED封装专利申请状况

#### 4.2.3 LED封装行业技术特点

#### 4.2.4 LED封装技术创新进展

#### 4.2.5 LED封装技术壁垒分析

#### 4.2.6 LED封装业技术研发仍需加强

### 4.3 LED封装关键技术介绍

#### 4.3.1 大功率LED封装的关键技术

#### 4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求

#### 4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

## 第五章 2013-2015年LED封装设备及封装材料的发展

## 5.1 2013-2015年LED封装设备市场分析

### 5.1.1 LED封装设备需求特点

### 5.1.2 LED封装设备市场格局

### 5.1.3 LED封装设备国产化提速

### 5.1.4 LED前端封装设备竞争加剧

### 5.1.5 LED后端封装设备市场态势

### 5.1.6 LED封装设备市场发展方向

### 5.1.7 LED封装设备市场规模预测

## 5.2 LED封装的主要材料介绍

### 5.2.1 LED芯片

### 5.2.2 荧光粉

### 5.2.3 散热基板

### 5.2.4 热界面材料

## 5.3 2013-2015年中国LED封装材料市场分析

### 5.3.1 LED封装材料市场现状

### 5.3.2 2015年LED芯片产能分析

### 5.3.3 2015年LED荧光粉价格走势

### 5.3.4 LED封装辅料市场面临洗牌

### 5.3.5 LED封装环氧树脂市场潜力巨大

### 5.3.6 LED封装用基板材料市场走向分析

## 第六章 2013-2015年国内外重点LED封装企业分析

### 6.1 国外主要LED封装重点企业

#### 6.1.1 日亚化学 (NICHIA)

#### 6.1.2 欧司朗 (OSRAM GmbH)

#### 6.1.3 三星电子 (SAMSUNG ELECTRONICS)

#### 6.1.4 首尔半导体 (SSC)

#### 6.1.5 科锐 (CREE)

### 6.2 台湾主要LED封装重点企业

#### 6.2.1 亿光电子

#### 6.2.2 隆达电子

#### 6.2.3 光宝集团

#### 6.2.4 东贝光电

#### 6.2.5 宏齐科技

#### 6.2.6 佰鸿股份

### 6.3 内地主要LED封装重点企业

6.3.1 鸿利光电

6.3.2 瑞丰光电

6.3.3 长方照明

6.3.4 国星光电

6.3.5 木林森

6.3.6 杭科光电

6.3.7 晶台股份

第七章 :中国LED封装产业发展趋势及前景

7.1 LED封装产业未来发展趋势

7.1.1 功率型白光LED封装技术趋势

7.1.2 无金线封装成LED封装新走向

7.1.3 LED封装产业未来发展方向

7.2 中国LED封装市场前景展望

7.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观

7.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张

7.2.3 中国LED通用照明封装市场前景预测

图表详见正文.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/224804224804.html>